



第83期 事業報告書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

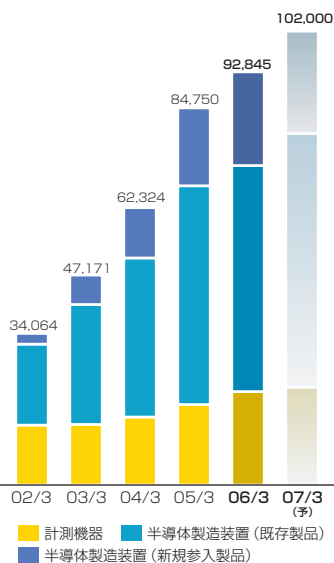
株式会社 東京精密

証券コード：7729

財務ハイライト

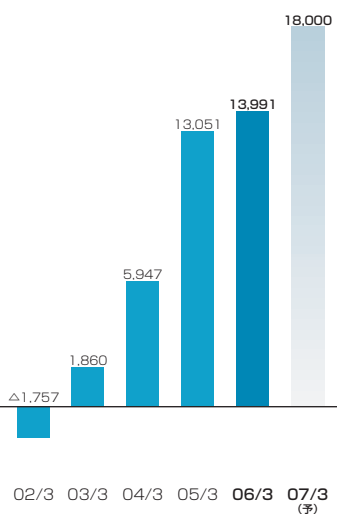
売上高

(百万円)



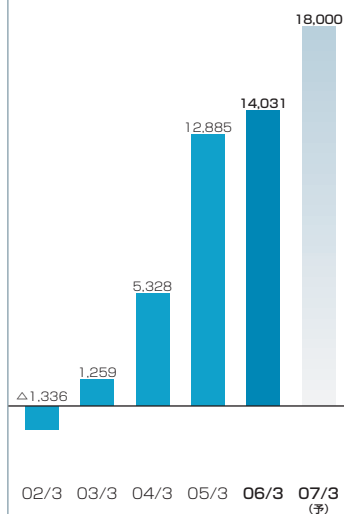
営業利益

(百万円)



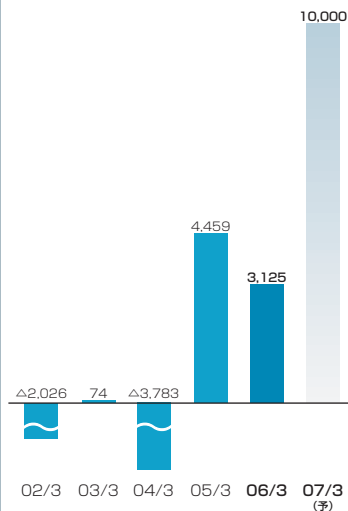
経常利益

(百万円)



当期純利益

(百万円)



主要財務指標(連結)

経営指標		05/3	06/3
営業利益率	%	15.4	15.1
経常利益率	%	15.2	15.1
当期純利益率	%	5.3	3.4
株主資本当期純利益率(ROE)	%	14.3	7.8
使用総資本当期純利益率(ROA)	%	4.6	3.0
使用総資本回転率	回	0.9	0.9
連結従業員数	人	1,144	1,169
従業員一人当たり売上高	千円	75,535	80,316
従業員一人当たり経常利益	千円	11,485	12,138
従業員一人当たり当期純利益	千円	3,975	2,704
一株当たり当期純利益(EPS)	円	118.82	80.77
株価収益率(PER)	倍	31.4	87.0
当座比率	%	125.8	132.1
流動比率	%	211.1	212.8
固定比率	%	82.5	61.7
固定長期適合率	%	42.9	40.1
負債比率	%	198.4	135.3
株主資本比率	%	32.7	42.5

株主の皆様へ



代表取締役社長 CEO兼COO

鈴木貞勝

東京精密(ACCURETECH)の株式を保有していただき、有難う存じます。厚く御礼申し上げます。

さて、当社は、株主の皆様が当社株式を保有していただいた目的に沿った経営を目指しております。

経営指標としましては、一株当たりの純利益(EPS)を長期的に増大させていくことを重視しております。これは当社が非常に重要と考えている「WIN-WIN」の関係を株主の皆様と会社との間で創りあげることにつながると確信しております。

当社は、技術指向型の会社です。上記の目的のために当社の経営の大原則である「製品開発の原則」(4頁掲載)に沿って技術開発を継続的に行っています。

また当社は、「世界No.1の製品を創る」という目的を共有できる企業および人材と積極的にパートナーシップを結び、革新的技術を搭載した市場創出型製品の開発を実現しています。「WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」というモットーのもと、異文化を包摂したグローバルかつハイブリッドな東京精密(ACCURETECH)の文化風土が醸成されており、世界No.1の製品開発体制の構築につながっています。

2001年1月に導入しましたコーポレートブランド「ACCURETECH(アクレーテク)」は、「共に成長する」という意味の“accrete”と“technology”「技術」の合成語です。「世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品を創り出し、皆様と共に大きく成長していく」という当社の企業理念を表したものです。

株主の皆様にも是非この企業理念にご賛同賜り、コーポレートブランド「ACCURETECH」のもと、さらなる飛躍を目指す当社に、今後とも格別なるご理解とご支援をお願い申し上げます。

FAQ...よくいただくご質問

FAQ-1

2005年度の業績について教えてください。

2005年度の連結売上高は928億45百万円(前期比9.6%増)、連結営業利益は139億91百万円(同7.2%増)、連結経常利益は140億31百万円(同8.9%増)となり、連結売上高は2年連続して過去最高を更新しました。また、連結当期純利益は、特別損失の計上により31億25百万円(同29.9%減)となりました。

【半導体製造装置部門】

半導体業界は、デジタル家電の需要増やパソコンの好調などにより、半導体メーカーの設備投資が旺盛で、製造装置に対する需要も伸長しました。この市況とニーズに応えるきめ細かい営業活動が奏功し、当期の受注高は、778億74百万円(前期比19.4%増)、売上高は、718億24百万円(同7.7%増)となり、ともに過去最高を更新しました。利益面では、売上増加とコストダウンの結果、89億72百万円(同2.1%増)の営業利益を計上し、前期比増益を達成しました。

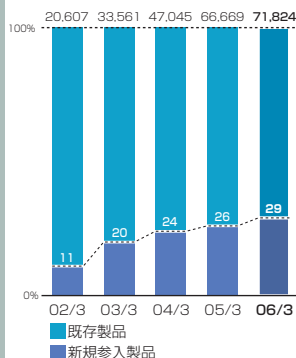
地域別にみると、国内、海外とも売上高は前期比大幅に伸び、海外では東アジア地域、特に韓国・中国向けが大きく伸長しました。製品別では、ウェーハプロービングマシンが、活発な市況を背景として躍進し、業績に大きく貢献しました。当社は圧倒的なシェアを誇る200mmウェーハ用プローバに加え、300mm用プローバでもトップシェアを獲得し、高い成長性を有するこの市場で世界シェアNo.1の地位をより強固なものにしました。また、ウェーハ外観検査装置、ポリッシュ・グラインダ、CMP装置の新規参入製品群は、その優れた製品コンセプトと性能を高く評価されています。その中でもポリッシュ・グラインダはウェーハ薄片化市場を事実上創出したとも言えるデファクトスタンダード(業界標準)マシンとなり、当期大きく伸長しました。

【計測機器部門】

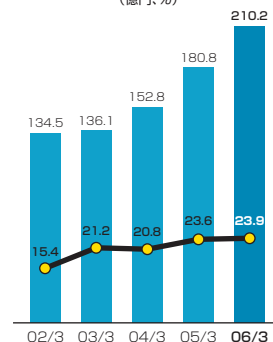
好調が続く自動車業界や工作機械業界などのユーザーニーズを確実に受注に取り込む営業努力と不断のコストダウンにより、当期の受注高は216億83百万円(前期比19.1%増)、売上高は210億20百万円(同16.3%増)、営業利益は、50億19百万円(同17.6%増)となり、4年連続で増収・増益を達成し、受注高・売上高・営業利益は3年連続で過去最高を更新しました。

当期は国内、海外ともに前期を上回りましたが、国内が特に大きく伸長しました。製品別では、業務提携をしているカールツァイス社(独)の解析・制御技術と当社の高剛性設計技術を融合させた三次元座標測定機「ザイザックスSVA」シリーズ、カールツァイス社製の新製品であるインライン向け三次元座標測定機「ゲージMAX」、リニアモーター採用で世界最高精度と低振動を実現した表面粗さ形状測定機「サーフコム」シリーズ、高精度で高評価を得ている真円度測定機「ロンコム」シリーズなど充

半導体製造装置
新規参入製品と既存製品の売上比率
(百万円、%)



計測機器
売上高・営業利益率
(億円、%)



実した製品ラインアップが売上増に大いに貢献しています。自動計測機器も、自動車業界の設備投資が活発であったことを反映して自動車部品の生産ラインなどで使用される「パルコム」シリーズが好調で、売上高は前年比大きく伸びました。

FAQ-2

2006年度の見通しについて教えてください。

2006年度の連結売上高は1,020億円(前期比9.9%増)と、3年連続で過去最高を更新するとともに、初めて1,000億円の大台を超えると予想しています。利益については、通期の連結営業利益が180億円(同28.7%増)、連結経常利益は180億円(同28.3%増)、連結当期純利益は100億円(同3.2倍)と共に過去最高を予想しています。

【半導体製造装置部門】

今期の半導体市場は、前期を上回る水準で好調に推移すると見込まれ、半導体メーカーなどの活発な設備投資が期待されます。このような状況を踏まえ、当社は、2006年度の半導体製造装置事業について、既存製品および新規参入製品ともに良好な市場環境にあると考えています。

既存製品のウェーハプロービングマシンは、テスト項目の増加やウェーハレベルでのテストニーズの高まりなどにより市場が拡大する中で、マーケットシェアも伸び、受注・売上とも前期比大きく伸びると予想しています。また、ウェーハダイシングマシンについても、ブレードダイシングマシンの新製品「A-WD-300TX」とレーザダイシングマシン「MAHOH DICING MACHINE」による売上増が見込まれます。

新規参入製品についても、ポリッシュ・グラインダは、引き続き好調な推移が見込まれ、ウェーハ外観検査装置とCMP装置も、新規顧客開拓と既存顧客からのリピートオーダーの双方が伸長し売上増が期待できます。

以上より、半導体製造装置部門の2006年度の売上高は、800億円(前期比11.4%増)と予想しています。業界水準を上回る伸びが期待でき、2005年度に続き過去最高を更新する見通しです。

【計測機器部門】

計測機器事業についても、2006年度も引続き、自動車関連をはじめ工作機械、ベアリングなどの各ユーザーから強い需要が見込まれ、好調に推移すると考えています。

このような状況を踏まえ、お客様のニーズを的確に捉えた製品ラインアップと営業努力により、2006年度売上高は220億円(前期比4.7%増)と4期連続で過去最高の更新を計画しています。



次世代高速 ウェーハダイシングマシン 「A-WD-300TX」

毎分80,000回転のスピンドル回転数と秒速1,000mmのX軸移動速度で高速切断と高加工品質を実現した世界最高レベルの技術を誇る新製品です。



真円度測定機 「TRONDCOM(ロンコム)44/54」

小型・普及クラスを超えた高い精度かつ世界標準機としての操作性を搭載しており、国内外ともに引き続き好調な販売が見込まれています。

FAQ-3

東京精密の強みとは何ですか。

当社の最大の強みは、やはり「製品開発の原則」(右)に則った製品の開発力です。この「製品開発の原則」は、技術指向の当社にとって、企業として継続的に成長していくために非常に重要な製品開発の原則を明文化したものです。

当社は、この「製品開発の原則」に即して、技術参入障壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い分野に数々の製品を投入してきました。また同時にマーケットニーズをいち早く察知し、ニーズの先をゆく新製品の投入も積極的に行ってまいりました。

ポリッシュ・グラインダは、薄物ウェーハ市場の将来性にいち早く着目し、その将来のマーケットを見越して開発した製品で、そのコンセプトは予想通りお客様から好評をいただき、その優れた性能をもって今日の市場を創出したといえます。

このように新しい領域に踏み込んでいけるのは、それだけの技術の蓄積や開発にかける会社としての真摯な姿勢があるからであり、これが当社の強さの現れである「競争力」を一層高めることとなります。

No.1の製品を作るためには、時として世界中の優れたパートナーと手を結び、協力し合うことも必要です。浜松ホトニクス(株)と共同開発したレーザダイシングマシン[MAHOHDICING MACHINE]は、水やブレード(刃)を一切使わず、高速でウェーハを個々のチップに分割することができる画期的な製品です。次世代のダイシング技術を担うこのマシンは、最先端のレーザー技術を有する浜松ホトニクス社と最先端のダイシング装置技術を有する当社とのタッグによって誕生しました。このように開発期間と開発コストを大幅に短縮することを可能にし、かつ世界No.1の技術を搭載した製品を送り出すことができる効果的なアライアンスを今後も積極的に活用してまいります。

一方、成熟市場におけるビジネスについて、良好な収益基盤を維持するためにもアライアンスを活用しています。例えば、1995年に同じ市場に製品を送り込む競合相手であったカールツァイス社と業務提携をするという当時としてはめずらしい、ビジネス環境の変化に対応した協業を開始し、大きな成果をあげています。

FAQ-4

2006年4月から中期経営計画をスタートさせたと聞きました。どのような計画なのでしょう。

当社が創立60周年を迎える2008年度(2009年3月28日で創立60周年)までの3年間を実行期間とする中期経営計画「AA60 (ACCRETECH Action 60)」を策定しました。ちょうど2008年は、北京オリンピックの年でもあり、これまでの

製品開発の原則

1. 世界No.1の製品を創る。
マーケットシェアNo.1の商品は
(1) 好況時の利益の極大化がはかれる。
(2) 不況時の損失の極小化がはかれる。
2. 研究開発投資は自己資金で。
3. 開発は技術参入障壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い分野を狙う。
4. 相応しいパートナーを見つけ、開発コストをシェアするとともに開発の成果を共有する。

ポリッシュ・グラインダ
「PG300DRM」

裏面研削とダメージ層を除去するポリッシングの2つの工程を1台で処理するポリッシュ・グラインダは、さらなる進化を遂げています。年々ウェーハは薄くなり、ますます取り扱いが困難になるため、周辺の工程をポリッシュ・グラインダ装置の中に取り込んでいく方向にあります。「PG300DRM」は、5つの機能を1台で処理する装置です。

経験から、この時期の半導体市況は非常に好調に推移することが予測されています。また、国内自動車メーカーを中心に、2008年度まで積極的に設備投資をしていく見通しが発表されており、計測機器事業についても良好な事業環境が期待できます。

こうした見通しの中、中期経営計画「AA60」における2008年度の目標は、半導体製造装置部門の連結売上高1,000億円、計測機器部門の連結売上高250億円、全体の営業利益率25%です。この目標に対して、製品グループ毎に、数値目標、達成のための製品戦略および具体的な取組み内容が明確になっており、それらの着実な遂行により中期経営計画の達成を図っていきます。

近年、お客様から短納期や高品質への要望がますます強くなっています。当社は、2005年3月に計測機器(土浦工場)、半導体製造装置(八王子工場)の工場を完成させ、生産性の向上を図りました。中期経営計画「AA60」では、さらに品質の向上と生産革新を推進し、リードタイムの短縮やコストダウンを実現していきます。

FAQ-5

株主価値の最大化への取り組みについてお聞かせください。

当社は、株主の皆様が当社株式を所有する目的に沿った経営を行っています。したがって、一株当たり利益の長期的な上昇と、その結果としての企業価値の長期的な上昇を、経営上の重要な指標と考えています。また、当社は企業が持続的な成長を実現し、企業価値を高めていくためには、国際化と株主重視の経営に適合したコーポレートガバナンスの充実が不可欠と認識しており、実効性ある内部統制システムの構築とコンプライアンス体制の確立により、コーポレートガバナンスを強化し、経営の健全性と透明性を確保していきます。

配当に関しては、将来の事業展開のための企業体質強化に配慮し、株主の皆様の長期的視点を重視しつつ、連結当期純利益に対する配当性向20%を目途に実施していく考えです。2005年度の配当については、中間配当として一株当たり20円を実施しました。期末配当については、特別損失はありましたが、長期的視点で保有していただいている株主の皆様の視点と当社の財務状況を踏まえ、一株当たり20円を継続し、一株当たり年間配当で40円を予定しています。なお、新会社法の施行後の配当方針については、現時点では従来どおりの中間期末日、期末日を基準とした年2回の配当を継続する予定です。また、2006年度の配当については、10円増配し、年間50円(中間配当金25円)を予定しています。

AA60 ターゲット

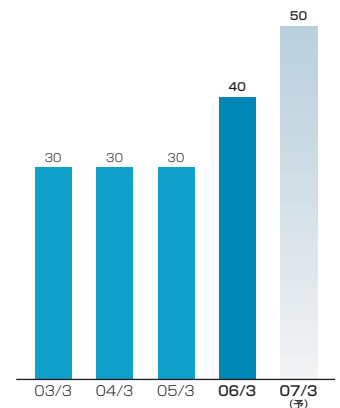
売上高 1,250 億円

半導体製造装置 1,000 億円

計測機器 250 億円

営業利益率 25%

一株当たり配当金(年間) (円)



社会を支えるアクレーテクの技術 「半導体製造装置：ウェーハ外観検査装置」

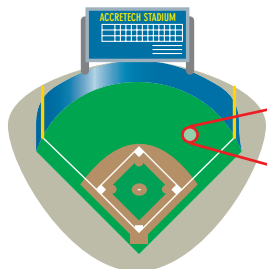
微細化*でますますニーズが高まる装置!! ウェーハ外観検査装置「WIN-WIN50」シリーズ



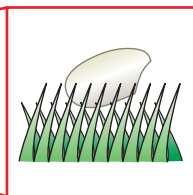
*微細化とは：
半導体デバイスを形成する部品、配線が
小さく、細くなっていくこと。

**「広い野球グラウンドに落ちている一粒のお米を見つけ出す」のと同じ
レベルで半導体ウェーハ上の小さな欠陥を見つける検査装置です!!**

携帯電話、デジタル家電製品、ゲーム機器、自動車など、私たちの身の回りでは多くの製品に半導体デバイスが使用されています。例えば携帯電話は、年々、小型・高性能化が進んでおり、それを実現するための半導体デバイスも小型化、かつその中に多くの機能を詰め込まなければならないため、半導体デバイスを形成する部品、配線も小さく、細くなってきています。現在、最先端の半導体デバイスでは配線の幅が0.1 μ m(1mmの1万分の1)を切るようになってきており、製造する側にも高度な技術が要求されます。このような高度な技術を用いてもやはりデバイスの中で配線がショートしたり、断線してしまうといった問題が発生してしまいます。ウェーハ外観検査装置はこうした半導体デバイスの製造工程で発生する微細な問題箇所を発見することで、不良品の割合を抑え、良品率を向上させることに寄与する装置です。



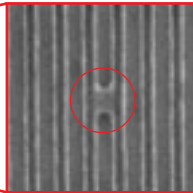
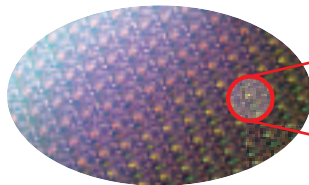
半導体ウェーハ (直径300mm)



野球場の広さを半導体ウェーハの表面に例えると、欠陥は芝生に落ちている米粒に相当します。「WIN-WIN 50」シリーズは、これを何と10分程度で見つけ出すことができます!



半導体ウェーハ上の欠陥の一例 (直径50nm)



ココが凄い!

1 高感度

最先端の半導体デバイスを製造する際には、ウェーハ上で50nm(1mmの2万分の1)程度の小さな欠陥を見つける必要があります。個人差もありますが、髪の毛1本の太さは50um程度なので、その1,000分の1にあたる50nmという極めて微細な欠陥を、外観検査装置「WIN-WIN 50」シリーズは検出できるのです!

2 スピード

半導体デバイスの基になるシリコンウェーハは直径300mmが主流ですが、これを野球グラウンドに例えますと、ウェーハ外観検査装置で検出する欠陥は1mmにも満たない砂粒に相当します。今、分かりやすくこの砂粒を米粒と例えますと、野球グラウンドに落ちている米粒がどこにあるのかを10分程度の時間で見つけるのがウェーハ外観検査装置に課せられているスピードの条件と言えます。「WIN-WIN 50」シリーズではCCDカメラで捉えたデバイスの像を比較して欠陥を検出しますが、1秒間に10億画素以上の処理をしています!

3 汎用性

半導体デバイスは完成するまでに300~500の工程を経ます。この工程のどこかで欠陥が発生すれば、最終製品としての半導体デバイスは動作しなくなります。最も欠陥の出やすい工程にウェーハ外観検査装置を適用して良品率の向上を図りますが、その工程はデバイスの種類や構造によっても、デバイスメーカーによっても異なりますので、なるべく多くの工程に使える外観検査装置を提供することが重要です。「WIN-WIN 50」シリーズは光学系や検査アルゴリズムに工夫をこらした、汎用性の非常に高い装置なのです。

連結財務諸表

注:連結財務諸表の数値は百万円以下を切り捨てて表示しています。

連結貸借対照表

単位:百万円

科目	第82期 (05.03.31)	第83期 (06.03.31)
流動資産	73,752	81,067
固定資産	27,240	28,807
有形固定資産	13,885	14,317
無形固定資産	2,581	4,837
投資その他の資産	10,773	9,653
繰延資産	0	-
資産合計	100,993	109,875

単位:百万円

科目	第82期 (05.03.31)	第83期 (06.03.31)
流動負債	34,941	38,099
固定負債	30,538	25,072
負債合計	65,479	63,172
少数株主持分	2,510	-
資本		
資本金	7,392	9,447
資本剰余金	12,017	20,466
利益剰余金	13,596	15,399
その他有価証券評価差額金	70	1,340
為替換算調整勘定	△ 9	139
自己株式	△ 63	△ 90
資本合計	33,003	46,703
負債、少数株主持分及び資本合計	100,993	109,875

貸借対照表

当期末における総資産は、前期末比89億円増の1,099億円となりました。流動資産では、現預金他が40億円増、売上増加に伴う売上債権が43億円増、在庫が11億円減、また、固定資産では、八王子・土浦に建設した新工場関連設備や内作強化のための300mm対応機械設備を中心に前期末比16億円増となりました。負債は、前期末比23億円減の632億円となりました。生産増加に伴う仕入債務は増加したものの、ユーロ円CBの転換や未払金の減少などにより負債合計は減少となりました。なお、有利子負債は前期末比36億円減少しました。また、東精エンジニアリングの完全子会社化に伴って、少数株主持分は0（前期末比25億円減）となりました。

連結損益計算書

単位:百万円

科目	第82期 (04.04.01~05.03.31)	第83期 (05.04.01~06.03.31)
売上高	84,750	92,845
売上原価	59,344	65,873
売上総利益	25,405	26,971
販売費及び一般管理費	12,354	12,980
営業利益	13,051	13,991
営業外収益	278	875
営業外費用	443	835
経常利益	12,885	14,031
特別利益	523	116
特別損失	7,007	6,281
税金等調整前当期純利益	6,401	7,865
法人税、住民税及び事業税	3,187	1,690
法人税等調整額	△ 1,688	2,851
少数株主利益	444	198
連結当期純利益	4,459	3,125

特別損失について

財務体質改善と今後の収益基盤強化の観点より、当期に、特別損失を63億円計上いたしました。主要な内訳としては、半導体製品の旧機種についてのたな卸廃棄損および評価損として約28億円と、リーブル関連設備の固定資産除却損およびリース解約費用として約32億円などです。

連結剰余金計算書

単位:百万円

科目	第82期 (04.04.01~05.03.31)	第83期 (05.04.01~06.03.31)
(資本剰余金の部)		
資本剰余金期首残高	11,806	12,017
資本剰余金増加高	211	8,448
株式交換による新株式の発行	-	6,218
新株予約権付社債の 新株予約権の権利行使	-	1,767
ストック・オプションの 新株予約権の権利行使	-	287
自己株式処分差益	-	175
新株引受権付社債の 新株引受権の権利行使	211	-
資本剰余金減少高	-	-
資本剰余金期末残高	12,017	20,466
(利益剰余金の部)		
利益剰余金期首残高	10,273	13,596
利益剰余金増加高	4,459	3,125
当期純利益	4,459	3,125
利益剰余金減少高	1,136	1,322
配当金	1,122	1,312
取締役賞与金	14	9
利益剰余金期末残高	13,596	15,399

連結キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円

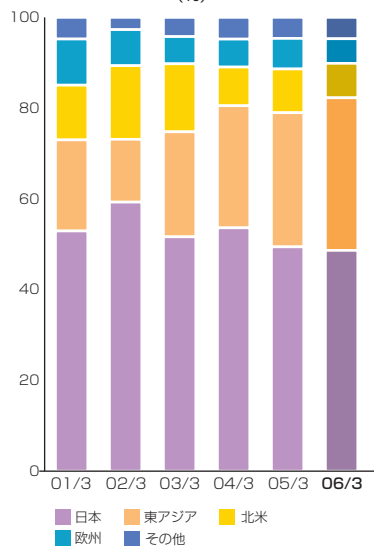
科目	第82期 (04.04.01~05.03.31)	第83期 (05.04.01~06.03.31)
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,058	8,346
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,769	△ 6,160
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,732	△ 290
現金及び現金同等物に係る換算差額	39	117
現金及び現金同等物の増減額	△ 403	2,012
現金及び現金同等物の期首残高	12,242	11,838
現金及び現金同等物の期末残高	11,838	13,851

キャッシュ・フロー

当期のキャッシュ・フローは営業活動については83億円の収入、投資活動については設備投資支出を中心に62億円の支出、財務活動については3億円の支出となりました。これにより、当期末における現金及び現金同等物は、前期末より20億円増加し、139億円となりました。

地域別売上高構成比

(%)



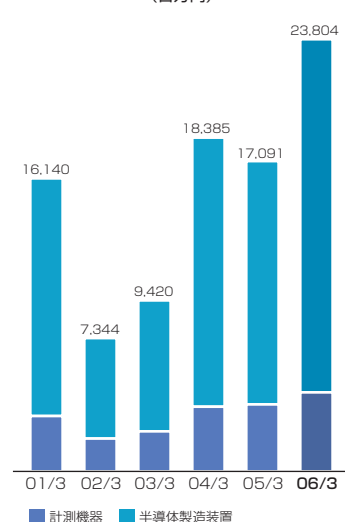
事業別売上高/受注高

(百万円)



事業別受注残高

(百万円)



財務諸表(個別)

注:財務諸表の数値は百万円以下を切り捨てて表示しています。

貸借対照表(個別決算)

単位:百万円

科目	第82期 (05.03.31)	第83期 (06.03.31)
流動資産	63,152	69,105
固定資産	24,009	26,484
有形固定資産	9,764	9,704
無形固定資産	2,287	1,460
投資その他の資産	11,958	15,320
資産合計	87,161	95,589

単位:百万円

科目	第82期 (05.03.31)	第83期 (06.03.31)
流動負債	30,684	34,520
固定負債	27,388	22,773
負債合計	58,073	57,293
資本		
資本金	7,392	9,447
資本剰余金	12,017	16,821
利益剰余金	9,674	10,776
その他有価証券評価差額金	67	1,340
自己株式	△ 63	△ 90
資本合計	29,088	38,295
負債及び資本合計	87,161	95,589

損益計算書(個別決算)

単位:百万円

科目	第82期 (04.04.01~05.03.31)	第83期 (05.04.01~06.03.31)
売上高	73,336	82,539
売上原価	55,563	63,172
売上総利益	17,773	19,367
販売費及び一般管理費	8,049	9,231
営業利益	9,723	10,135
営業外収益	342	867
営業外費用	389	579
経常利益	9,676	10,423
特別利益	523	97
特別損失	9,555	6,363
税引前当期純利益	644	4,157
法人税、住民税及び事業税	1,951	45
法人税等調整額	△ 1,911	1,697
当期純利益	605	2,414
前期繰越利益	3,903	3,383
中間配当額	562	749
当期末処分利益	3,945	5,047

利益処分

単位:百万円

科目	第82期 (04.04.01~05.03.31)	第83期 (05.04.01~06.03.31)
当期末処分利益	3,945	5,047
利益処分額	562	801
配当金	562	801
次期繰越利益	3,383	4,246

ネットワーク



1 本社 (業務会社)



2 八王子工場 (半導体社)
株式会社アクレーテック・マイクロテクノロジー



3 土浦工場 (計測社)



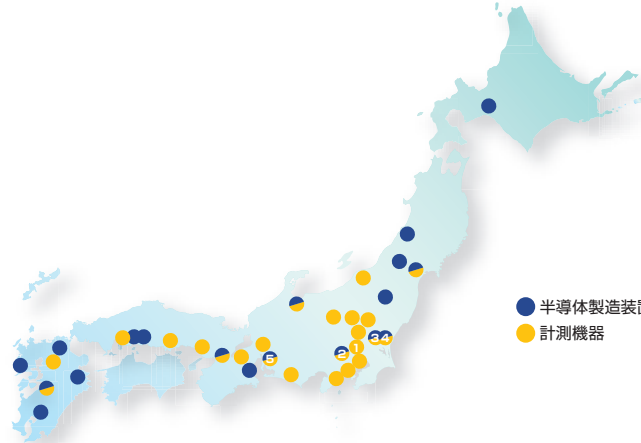
4 株式会社 依東精工エンジニアリング
本社・工場



5 株式会社 依東精工エンジニアリング
名古屋工場

国内主要拠点

(営業所・サービスステーション)



● 半導体製造装置
● 計測機器



6 Accretech USA, Inc.



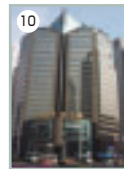
7 Accretech
(Europe) GmbH



8 Accretech
(Malaysia) Sdn. Bhd.



9 Accretech
(Singapore) Pte. Ltd.



10 Accretech
(China) Co., Ltd.

海外主要拠点

(営業所・サービスステーション)



● 半導体製造装置
● 計測機器

会社概要 (平成18年3月31日現在)

商号	株式会社 東京精密 (TOKYO SEIMITSU CO., LTD.)	
設立	昭和24年3月28日	
資本金	9,447,585,765円	
証券取引所	東京証券取引所 市場第一部	
会社が発行する株式の総数	110,501,100株	
発行済株式の総数	40,100,167株(うち、自己株式数26,421株)	
株主数	18,444名	
役員 <small>(平成18年6月29日現在)</small>	代表取締役社長 CEO兼COO	鈴木 貞勝
	代表取締役EVP 計測社担当	藤森 一雄
	代表取締役EVP 半導体社担当	長澤 英二
	代表取締役EVP兼CFO 業務会社担当	太田 邦正
	取締役グループCIO	梅中 茂
	取締役	ウォルフガング ボナツツ
	取締役	グレッグ セバスチャン
	取締役	吉田 均
	取締役	木村 龍一
	監査役(常勤)	高城 英明
	監査役	吉儀 肇
	監査役	山本 清次
	監査役	久富 眞志
	監査役	川原 栄次

従業員数 644名(単体)
1,169名(連結)

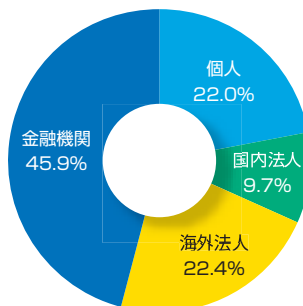
主要取引銀行	みずほコーポレート銀行	大手町営業部
	三井住友銀行	本店営業部
	みずほ信託銀行	本店営業部
	三菱東京UFJ銀行	新宿中央支社
	常陽銀行	土浦支店
	関東つくば銀行	本店営業部
	りそな銀行	吉祥寺支店

事業所	業務会社	東京都三鷹市
	半導体社	東京都八王子市
	計測社	茨城県土浦市
営業所	東北(宮城県仙台市)	長野(長野県岡谷市)
	○山形(山形県山形市)	浜松(静岡県浜松市)
	茨城(茨城県土浦市)	名古屋(愛知県三好町)
	宇都宮(栃木県宇都宮市)	小牧(愛知県北名古屋市)
	埼玉(埼玉県さいたま市)	京滋(滋賀県守山市)
	東京(東京都三鷹市)	◎大阪(大阪府吹田市)
	○東京(東京都八王子市)	加古川(兵庫県加古川市)
	西東京(東京都八王子市)	岡山(岡山県岡山市)
	川崎(神奈川県川崎市)	広島(広島県広島市)
	新潟(新潟県燕市)	九州(福岡県久留米市)
	厚木(神奈川県厚木市)	○九州(大分県大分市)
	北陸(富山県富山市)	
	(注)◎:全製品取扱 ○:半導体製品取扱 無印:計測製品取扱	

株式の状況

株主名	大株主	
	持株数(千株)	出資比率(%)
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	7,324	18.3
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	2,128	5.3
野村信託銀行株式会社(投信口)	1,245	3.1
財団法人精密測定技術振興財団	1,058	2.6
株式会社みずほコーポレート銀行	840	2.1
三井生命保険株式会社	660	1.6

所有者別状況 (株式数比率)



株主メモ

決算期	毎年3月31日
定時株主総会	毎年6月中 基準日毎年3月31日 その他必要あるときは、あらかじめ基準日を公告いたします。
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱所	〒135-8722 東京都江東区佐賀一丁目17番7号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 ☎0120-288-324 (フリーダイヤル)
同取次所	みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 全国各支店
株式取扱手数料	名義書換 無料 新株券交付 無料
公告	当社ホームページ、または日本経済新聞に掲載します。



キリトリ線

郵便はがき

料金受取人払

三鷹局承認

809

1 8 1 - 8 7 9 0

差出有効期限
平成18年10月
31日まで

東京都三鷹市下連雀9-7-1

株式会社 東京精密
業務会社 総務室 宛



決算説明会の 音声配信をしています。

決算説明会の音声と資料をホームページ上で配信しています。

期間:説明会終了後3ヶ月間
(最新の平成18年3月期決算説明会については8月16日まで掲載しています。)

【当社ホームページ】
<http://www.accretech.jp>



決算説明会の音声配信は
こちらをクリック

下記の音声配信のページが開きます。



- 「再生」ボタンで音声スタートします。
- 「進む」で説明資料のページが進みます。

是非ご活用ください。

TOKYO SEIMITSU
<http://www.accretech.jp>